

実装業界の本流にアクセスする技術専門誌

エレクトロニクス

# 実装技術 2012/2013

Electronic Packaging Technology

## Vol.28/29 年間特集予定表

月号	発行日	特集名	対象展示会	申込メ日	原稿メ日
<b>1</b> 月号	12月20日	●インターネブコン	インターネブコン・ジャパン (1/18~1/20)	11月20日	11月25日
<b>2</b> 月号	1月20日	●検査技術	nano tech (2/15~2/17)	12月20日	12月26日
<b>3</b> 月号	2月20日	●プリント配線版/フレキシブルプリント配線版		1月20日	1月25日
<b>4</b> 月号	3月20日	●製品製造現場(試作/EMS)	ファインテック・ジャパン (4/11~4/13)	2月20日	2月27日
<b>5</b> 月号	4月20日	●環境関連技術	NEW環境展 (5/22~5/25)	3月22日	3月26日
<b>6</b> 月号	5月20日	●プリント配線板製造	画像センシング展(5/30~6/1) JPCAショー(6/13~6/15) JISSO PROTEC(6/13~6/15)	4月20日	4月25日
<b>7</b> 月号	6月20日	●設計・解析・シミュレーション	設計・製造ソリューション展 (6/20~6/22)	5月21日	5月25日
<b>8</b> 月号	7月20日	●はんだ付け技術	マイクロマシン/MEMS展 (7/11~7/13)	6月20日	6月25日
<b>9</b> 月号	8月20日	●部品搭載技術		7月20日	7月25日
<b>10</b> 月号	9月20日	●電子部品	※CEATEC JAPAN	8月20日	8月27日
<b>11</b> 月号	10月20日	●実装工程を考える		9月20日	9月25日
<b>12</b> 月号	11月20日	●半導体実装(SiP、PoP、3次元実装)	※SEMICON JAPAN	10月22日	10月25日

## 2013

<b>1</b> 月号	12月20日	●インターネブコン(仮)	※インターネブコン・ジャパン	11月20日	11月26日
<b>2</b> 月号	1月20日	●検査技術(仮)	※nano tech	12月20日	12月25日
<b>3</b> 月号	2月20日	●プリント配線版/フレキシブルプリント配線版		1月21日	1月25日
<b>4</b> 月号	3月20日	●製品製造現場(試作/EMS)	※ファインテック・ジャパン	2月20日	2月25日
<b>5</b> 月号	4月20日	●環境関連技術	※NEW環境展	3月20日	3月25日
<b>6</b> 月号	5月20日	●プリント配線板製造	※画像センシング展 ※JPCAショー ※JISSO PROTEC	4月22日	4月25日
<b>7</b> 月号	6月20日	●設計・解析・シミュレーション	※設計・製造ソリューション展	5月20日	5月27日
<b>8</b> 月号	7月20日	●はんだ付け技術	※マイクロマシン/MEMS展	6月20日	6月25日
<b>9</b> 月号	8月20日	●部品搭載技術		7月22日	7月25日

※本内容は、編集の都合により変更になる場合もありますので、予めご了承下さい。